(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2014-127353 (P2014-127353A)

(43) 公開日 平成26年7月7日(2014.7.7)

(51) Int.Cl.			F I			テーマコード (参考)
H05B	33/12	(2006.01)	HO5B	33/12	\mathbf{E}	3 K 1 O 7
HO1L	51/50	(2006.01)	HO5B	33/14	A	
H05B	33/14	(2006.01)	HO5B	33/14	Z	
H05B	33/04	(2006.01)	HO5B	33/04		

審査請求 未請求 請求項の数 5 〇1 (全 10 頁)

		一 田 田 印	・
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2012-283408 (P2012-283408) 平成24年12月26日 (2012.12.26)	(71) 出願人	502356528 株式会社ジャパンディスプレイ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		東京都港区西新橋三丁目7番1号
		(74) 代理人	110000154
			特許業務法人はるか国際特許事務所
		(72) 発明者	徳田 尚紀
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社
			ジャパンディスプレイイースト内
		(72)発明者	豊田 裕訓
			千葉県茂原市早野3300番地 株式会社
			ジャパンディスプレイイースト内
		Fターム (参	考) 3K107 AA01 AA05 BB01 CC33 CC35
			EE22 EE27 EE42 EE49
		1	

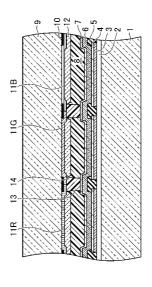
(54) 【発明の名称】E L表示装置

(57)【要約】

【課題】カラーフィルタ方式の E L 表示装置において、個々の画素が微細となる高精細又は小型の表示装置においても混色による画質の劣化を低減すること。

【解決手段】前面に画素毎に形成された下部電極4と、下部電極4を隔てる画素分離膜5と、下部電極4及び画素分離膜5の上層に形成された白色発光のEL層6と、を備えたアレイ基板1と、後面にブラックマトリクス10と、カラーフィルタ11R,11G,11Bと、オーバーコート層12を備えた封止基板9と、アレイ基板1と封止基板9間に充填された封止層8と、を有し、オーバーコート層12に、厚さの異なる部分が設けられたEL表示装置。

【選択図】図3



【特許請求の範囲】

【請求項1】

前面に画素毎に形成された下部電極と、前記下部電極を隔てる画素分離膜と、前記下部電極及び前記画素分離膜の上層に形成された白色発光のEL層と、を備えたアレイ基板と

後面にブラックマトリクスと、カラーフィルタと、オーバーコート層を備えた封止基板と、

前記アレイ基板と前記封止基板間に充填された封止層と、

を有し、

前記オーバーコート層に、厚さの異なる部分が設けられたEL表示装置。

【請求項2】

前記厚さの異なる部分は、前記オーバーコート層の厚さが薄くなっている薄膜部分又は前記オーバーコート層が除去されている開口部分であり、

前記薄膜部分又は前記開口部分に柱状スペーサが形成されている請求項1記載のEL表示装置。

【請求項3】

前記柱状スペーサは、平面視において前記カラーフィルタと重ならない位置に形成されている請求項2記載のEL表示装置。

【請求項4】

前記厚さの異なる部分は、平面視において前記ブラックマトリクスと重なる位置に形成された突起部分である請求項1記載のEL表示装置。

【請求項5】

前記厚さの異なる部分は、前記アレイ基板の前面の凹凸構造と相補的形状となるよう設けられている請求項1記載のEL表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[00001]

本発明は、EL表示装置に関する。

【背景技術】

[0002]

現在、種々の形式のエレクトロルミネセンス(以降、「EL」と表記)表示装置が開発され実用に供されている。特に、フルカラーのEL表示装置を携帯機器等の小型の機器に搭載するなど高精細かつ小型であることが要求される場合には、個々の画素のサイズが小さくなり、発光層であるEL層を画素毎に異なる発色光をもつものに塗り分けることが困難となる。

[0003]

そこで、カラーフィルタ方式のEL表示装置が提案されている。これは、図1に示すように、トップエミッション形式のEL表示装置400のアレイ基板1上に形成された発光層であるEL層6を白色発光のものとして全画素に跨る共通の層とし、封止層8を隔てて配置される封止基板9上に色要素であるカラーフィルタ11R、11G、11Bを設けたものである。EL層6より生じた白色光は、図中矢印Aで示すように、ここでは緑色のカラーフィルタ11Gを透過することにより緑色光として出射し、認識される。

[0004]

なお、図1に示す従来のカラーフィルタ方式のトップエミッション型 E L 表示装置 4 0 0 の画素部分を示す部分断面図には、アレイ基板1上に形成される回路層 2 、反射層 3 、下部電極 4 、画素分離膜 5 、 E L 層 6 及び上部電極 7 が示され、また、封止基板 9 上に形成されるブラックマトリクス 1 0 、カラーフィルタ 1 1 R 、 1 1 G 、 1 1 B 、オーバーコート層 1 2 及び柱状スペーサ 1 3 が示されている。

[0005]

図1に示したEL表示装置400では、図中矢印Bに示すように、EL層6から斜め方

10

20

30

40

向に出射する光線が隣接するカラーフィルタ11Bに入射することにより生じる混色が発生する。この混色は、個々の画素が微細となる高精細又は小型の表示装置では、隣接する画素間隔が狭くなるため、より顕著となり、場合によっては実用上の問題となる。混色の程度を低減するにはEL層6からカラーフィルタ11R、11G、11Bまでの距離を短くすればよいが、封止層8の厚さを決定する柱状スペーサ13の高さには製造上の制限があり、一定程度より低くすることができない。柱状スペーサ13を省略して封止層8を薄くすることも考えられるが、その場合には、アレイ基板1表面の凹凸の影響が強くなり、封止層8を形成する樹脂をアレイ基板1と封止基板9間に均等に充填することが難しい。

[0006]

上述の混色の問題を解決するため、例えば特許文献 1 では、各発光画素と他の発光画素の間にスペーサを兼ねる遮光部を設けることが提案されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0007]

【特許文献 1 】特開 2 0 0 2 - 2 9 9 0 4 4 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[00008]

特許文献1の技術では、遮光部材には黒色樹脂材料が用いられ、エッチング等の手法により所望のパターンに加工される。しかしながら、スペーサを兼ねる程度の厚膜の場合、膜のプロファイルがエッチング時にテーパ形状あるいはアンダーカット形状となりやすく、微細加工が困難である。また、黒色樹脂材料は紫外線透過率が低いため、厚膜の場合、黒色樹脂材料自体を感光性とすることによるフォトリソグラフィ加工も難しい。そのため、同文献記載の技術は個々の画素が微細となる高精細又は小型の表示装置に適用することはできない。

[0009]

本発明はかかる観点に鑑みてなされたものであって、その目的は、カラーフィルタ方式のEL表示装置において、個々の画素が微細となる高精細又は小型の表示装置においても混色による画質の劣化を低減することである。

【課題を解決するための手段】

[0010]

本出願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

[0011]

(1)前面に画素毎に形成された下部電極と、前記下部電極を隔てる画素分離膜と、前記下部電極及び前記画素分離膜の上層に形成された白色発光のEL層と、を備えたアレイ基板と、後面にブラックマトリクスと、カラーフィルタと、オーバーコート層を備えた封止基板と、前記アレイ基板と前記封止基板間に充填された封止層と、を有し、前記オーバーコート層に、厚さの異なる部分が設けられたEL表示装置。

[0012]

(2)(1)において、前記厚さの異なる部分は、前記オーバーコート層の厚さが薄くなっている薄膜部分又は前記オーバーコート層が除去されている開口部分であり、前記薄膜部分又は前記開口部分に柱状スペーサが形成されている EL表示装置。

[0 0 1 3]

(3)(2)において、前記柱状スペーサは、平面視において前記カラーフィルタと重ならない位置に形成されている EL表示装置。

[0014]

(4)(1)において、前記厚さの異なる部分は、平面視において前記ブラックマトリクスと重なる位置に形成された突起部分である EL表示装置。

[0015]

10

20

30

(5)(1)において、前記厚さの異なる部分は、前記アレイ基板の前面の凹凸構造と 相補的形状となるよう設けられている EL表示装置。

【発明の効果】

[0016]

上記(1)によれば、カラーフィルタ方式のEL表示装置において、個々の画素が微細となる高精細又は小型の表示装置においても混色による画質の劣化を低減することができる。

[0017]

上記(2)によれば、柱状スペーサの高さを実質的に低くすることができる。

[0 0 1 8]

上記(3)によれば、柱状スペーサの高さをさらに実質的に低くすることができる。

[0019]

上記(4)によれば、オーバーコート層の形状により柱状スペーサを代替することができる。

[0020]

上記(5)によれば、封止層を形成する樹脂のアレイ基板と封止基板間への充填を円滑に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

- [0021]
- 【図1】従来のカラーフィルタ方式のトップエミッション型EL表示装置の画素部分を示す部分断面図である。
- 【図2】本発明の第1の実施形態に係るEL表示装置の概略分解斜視図である。
- 【図3】本発明の第1の実施形態に係るEL表示装置の画素部分を示す部分断面図である
- 【図4】本発明の第1の実施形態に係るEL表示装置の変形例における、柱状スペーサ近辺を示す部分断面図である。
- 【図5】本発明の第2の実施形態に係るEL表示装置の画素部分を示す部分断面図である
- 【図6】本発明の第3の実施形態に係るEL表示装置の画素部分を示す部分断面図である

【発明を実施するための形態】

[0022]

以下、本発明の第1の実施形態に係るEL表示装置100を図面を参照しつつ説明する

[0 0 2 3]

図2は、本発明の第1の実施形態に係るEL表示装置100の概略分解斜視図である。EL表示装置100は、矩形のアレイ基板1の前面上に、画素20が配置されている領域である矩形の表示領域21が設けられている。表示領域21の左右いずれかの辺また表で側の辺に隣接して、走査回路22が配置される。本実施形態では、走査回路22は表示領域21の左側のみに設けられている。走査回路22からは多数の走査信号線23が表示領域21に延びる。なお、走査回路22は、図示のように、回路自体をいわゆるSOGGSystem On G1ass)等の手法によりアレイ基板1の表面に直接作成する表ではより設けてもよいし、半導体チップを実装することにより設けられる。駆動回路24からは多元の映像信号線25が表示領域21に延びており、走査信号線23と直交する。この走査信号線23と映像信号線25に接続して一つの画素20が配置される。なお、駆動回路24は、走査回路22と同様にアレイ基板1の表面に直接作成して設けてもよいが、本実施形態では、半導体チップを実装することにより設けている。駆動回路24にはFPC(F1e×ib1e Printed Circuit)26が接続されており、外部の機器から画像データが駆動回路24に供給されるようになっている。

10

30

20

40

[0024]

さらに、アレイ基板1の前面側には、封止基板9が配置される。封止基板9の後面には、カラーフィルタ11R,11G,11Bが表示領域21の各画素20に対応する位置に形成されている(図中破線で示した)。また、封止基板9はアレイ基板1より寸法が小さく、駆動回路24及びFPC26が封止基板9に覆われることなく露出するようになっている。本実施形態では、封止基板9の図中奥行き方向(長辺)の寸法がアレイ基板1の奥行き方向の寸法より小さいものとなっており、封止基板9の図中幅方向(短辺)の寸法はアレイ基板1の幅方向の寸法と同じである。なお、本明細書では、「前面」を、EL表示装置100の観察者に向く側の面を、「後面」をその反対に向く面を指す用語として用いている。

[0025]

外部の機器から供給された画像データは、駆動回路24により画素20毎の輝度を示す電圧信号に変換されて映像信号線25に出力され、走査回路22により選択された走査信号線23に対応する画素20に供給される。画素20は、それぞれの画素20に設けられた画素回路により、供給された電圧信号に応じた輝度で発光する。このようにして、表示領域21に格子状に設けられた多数の画素20が所与の画像データに対応した輝度で発光することにより、EL表示装置100は表示領域21に画像を形成する。

[0026]

図3は、本発明の第1の実施形態に係るEL表示装置100の画素部分を示す部分断面図である。

[0027]

EL表示装置100は、絶縁性のアレイ基板1上に多数の画素を規則的に配置し、各画素に対応する位置におけるEL層6の発光量を制御することにより画像を形成する。そのため、アレイ基板1上には、各画素に流れる電流の量を制御するためのTFT(ThinFilm Transistor)等からなる電気回路が規則的に(本実施形態の場合、格子状に)配置される回路層2が形成される。なお、アレイ基板1は本実施形態ではガラス基板であるが、絶縁性の基板であればその材質は特に限定されず、合成樹脂その他の材質であってもよい。また、その透明・不透明も問わない。

[0 0 2 8]

回路層 2 は、適宜の絶縁層と、走査信号線、映像信号線、電源線及び接地線等からなる配線と、ゲート、ソース、ドレインそれぞれの電極と半導体層からなるTFTを含んでいる。回路層 2 を構成する電気回路及びその断面構造は周知のものであるので、ここではその詳細は省略し、これらを単純化して単に回路層 2 としてのみ示す。

[0029]

回路層2上には、画素毎に独立して反射層3が設けられている。反射層3は、そのさらに上層に設けられる E L 層 6 からの発光を反射する機能を有している。反射層3は適宜の金属膜により形成してよく、例えばアルミニウム、クロム、銀又はこれらの合金を用いてよい。なお、反射層3は、次に説明する下部電極4により兼ねるものとして省略してもよい。或いは、反射層3と下部電極4とが任意の絶縁層等により絶縁されている場合には、反射層3は必ずしも画素毎に独立して設けられずともよく、例えば表示領域21(図2参照)全面を覆うように設けられてもよい。

[0030]

反射層 3 のさらに上層には、画素毎に下部電極 4 が設けられる。下部電極 4 は、画素分離膜 5 (バンクとも呼ばれる)により互いに隔てられ、絶縁される。下部電極 4 は透明導電膜であり、ITO(酸化インジウム錫)やInZnO(酸化亜鉛錫)等の導電性金属酸化物や、かかる導電性金属酸化物中に銀等の金属を混入したものが好適に用いられる。下部電極 4 が反射層 3 を兼ねるものである場合には、これを単なる金属薄膜としてもよい。また、画素分離膜 5 は絶縁性の材料であればどのようなものであってもよく、ポリイミドやアクリル樹脂等の有機絶縁材料や、シリコンナイトライドにより形成してよい。画素分離膜 5 は、各画素の境界に沿って配置され、各画素を互いに分離する。

10

20

30

40

10

20

30

40

50

[0031]

下部電極4及び画素分離膜5の上層には、EL層6が設けられる。EL層6は、画素毎に独立しておらず、表示領域21(図2参照)全面を覆うように設けられる。また、EL層6の発光色は白色である。かかる白色の発光は、一般的には、複数色、例えば、赤、緑、青の各色や、黄色と青に発光するEL材料を積層することにより合成色として得られるが、本実施形態においてEL層6の具体的構成は特に限定されるものではなく、その単層 / 積層の別やその層構造については、結果として白色発光が得られるものであればどのようなものであってもよい。また、EL層6を構成する材料は、有機であっても無機であってもよいが、本実施形態では有機材料を使用している。

[0032]

さらに、EL層6の上部には、上部電極7が設けられる。上部電極7もまた、画素毎に独立しておらず、表示領域21(図2参照)全面を覆うように設けられる。上部電極7も透明導電膜であり、ITO(酸化インジウム錫)やInZnO(酸化亜鉛錫)等の導電性金属酸化物に銀やマグネシウム等の金属を混入したもの、銀やマグネシウム等の金属薄膜と導電性金属酸化物を積層したもの、或いは単なる金属薄膜が好適に用いられる。

[0033]

かかる構造により、アレイ基板 1 の前面に位置する上部電極 7 は凹凸を有する構造となっている。図 3 では、画素分離膜 5 に対応する部分が凸となり、それ以外の部分では平坦な凹となるものとして示されているが、これにさらに回路層 2 に形成されたTFTやスルーホール等の各種の構造による凹凸が反映されたものとなる。なお、上部電極 7 のさらに上層に任意の材料による保護層を形成してもよいが、その場合には、かかる保護層が上部電極 7 と同様の凹凸構造を有することとなる。

[0034]

アレイ基板1の前面側には、封止層8が設けられ、EL層6をはじめとする各層への酸素や水分の侵入が防止され、保護される。封止層8は、保護性能に優れた有機材料で構成してよく、また、異種材料を複数積層することにより封止層8を構成してもよい。封止層8には透明の材料が選択される。

[0035]

封止層 8 を挟んで、アレイ基板 1 と向かい合うように設けられる封止基板 9 が配置されており、封止基板 9 の後面、すなわち、アレイ基板 1 と向き合う面には、画素の境界となる部分にブラックマトリクス 1 0 が形成され、さらにその上を覆うように、各画素に対応した位置に、各画素の発光色に対応した色のカラーフィルタ 1 1 R、 1 1 G、 1 1 Bが形成されている。封止基板 9 は、ガラスあるいは合成樹脂製であり、可視光に対して透明である。また、ブラックマトリクス 1 0 は、可視光に対して黒色、すなわち、吸光性を有する材料であればどのようなものであってもよく、例えば、ポリイミドやアクリル系合成樹脂にカーボンを混入したものを用いてよい。また、カラーフィルタ 1 1 R、 1 1 G及び 1 1 B は任意の合成樹脂、例えばアクリル系合成樹脂に染料材料を混入することによりそれぞれ赤色、緑色及び青色に着色したものである。

[0036]

さらに、カラーフィルタ11R、11G及び11Bを覆うようにオーバーコート層12が形成され、カラーフィルタ11R、11G及び11Bの保護と表示領域21内での封止基板9の後面の平坦化がなされている。オーバーコート層12のブラックマトリクス10と平面視において重なる位置には、オーバーコート層12の厚さの異なる部分として、ここでは部分的にオーバーコート層12が除去された開口部分14が設けられており、カラーフィルタ11R、11G及び11Bがオーバーコート層12から露出している。さらに、開口部分14内に、柱状スペーサ13が形成されている。オーバーコート層12、柱状スペーサ13にはアクリル系、ポリイミド系等の適宜の合成樹脂を用いてよい。

[0037]

このような構造により、EL表示装置100の各画素に対応する位置にあるEL層6は、回路層2に配置された電気回路により制御された量の正孔及び電子が下部電極4及び上

部電極 7 により注入されると、その電流量に応じた輝度で発光する。下部電極 4 及び上部電極 7 の極性は特に限定されないが、本実施形態では、下部電極 4 がアノードとして、また、上部電極 7 がカソードとして機能するようになっている。また、以上の説明及び図 1 より明らかなように、 E L 表示装置 1 0 0 はいわゆるトップエミッション形式であり、アレイ基板 1 の前側に発光を取り出す。

[0038]

ここで、封止層8は、アレイ基板1と封止基板9間に封止樹脂を充填した後硬化させることにより作成されるが、その際にアレイ基板1と封止基板9を互いに押し付け合うよう加圧するので、封止層8の厚さは主として柱状スペーサ13の高さにより決定される。そして、本実施形態では、柱状スペーサ13が形成される位置において、オーバーコート層12に開口部分14が設けられているため、オーバーコート層12の厚みの分だけ柱状スペーサ13の高さが実質的に低くなっている。そのため、アレイ基板1と封止基板9間の距離がオーバーコート層12の厚みの分だけ短くなり、混色の程度が軽減される。

[0039]

なお、本実施形態では、柱状スペーサ13が形成される位置にオーバーコート層12を除去した開口部分14を設けたが、これに換え、オーバーコート層12を完全に除去することなく、その厚さを低減した薄膜部分を設けるようにしてもよい。開口部分14、薄膜部分はオーバーコート層12を形成する際に、フォトリソグラフィの手法を用い、エッチングを行ったり、いわゆるハーフ露光を行ったりすることにより形成される。

[0040]

なお、図3に示した例では柱状スペーサ13はカラーフィルタ11R、11G及び11Bの表面に形成したが、図4に示すように、カラーフィルタ11R、11G及び11Bと重ならない位置であって、ブラックマトリクス10の表面に直接形成するようにしてもよい。ブラックマトリクス10の幅が、カラーフィルタ11R、11G及び11Bとの重ね合わせしろを考慮してもなお、柱状スペーサ13を形成できる程度に太い場合には、かかる構造をとることにより、さらに柱状スペーサ13の高さが実質的に低くなる。

[0041]

なお、図3では柱状スペーサ13がアレイ基板1の表面(上部電極7)に接触しているように示されているが、必ずしも柱状スペーサ13はアレイ基板1の表面に突き当たる必要はない。

[0042]

続いて、本発明の第2の実施形態に係るEL表示装置200を図面を参照しつつ説明する。なお、EL表示装置200の外観は先の第1の実施形態に係るEL表示装置100のものとして図2に示したものと同一である。また、本実施形態に係るEL表示装置200を説明するにあたり、第1の実施形態と同一または同等の構成に対しては同符号を付し、重複する説明は省略する。

[0043]

図5は、本発明の第2の実施形態に係るEL表示装置200の画素部分を示す部分断面図である。EL表示装置200では、オーバーコート層12のブラックマトリクス10と平面視において重なる位置に、オーバーコート層12の厚さの異なる部分として、ここでは部分的にオーバーコート層12の厚さの厚い突起部分15が設けられている。この突起部分15は、先に説明した背景技術又は第1の実施形態における柱状スペーサの機能を代替するものであり、EL表示装置200の製造時に封止層8の厚さを決定する役割を担っている。

[0044]

突起部分15はオーバーコート層12を形成する際に、フォトリソグラフィの手法を用い、エッチングを行ったり、いわゆるハーフ露光を行ったりすることにより形成することができる。すなわち、エッチングによる場合にはオーバーコート層12全体を突起部分15と同じ厚さで形成し、その後突起部分15以外の部分をエッチングにより除去し、その厚みを減じればよい。また、ハーフ露光による場合には、オーバーコート層12を形成す

10

20

30

40

る樹脂を封止基板 9 上に塗布した後、突起部分 1 5 以外の部分にはハーフトーンマスクによるハーフ露光を行い、その後現像すればよい。オーバーコート層 1 2 の厚さは比較的自由に定めることができるので、このようにしても柱状スペーサの高さを実質的に低くすることができる。

[0045]

続いて、本発明の第3の実施形態に係るEL表示装置300を図面を参照しつつ説明する。なお、EL表示装置300の外観もまた、先の第1の実施形態に係るEL表示装置100のものとして図2に示したものと同一である。また、本実施形態に係るEL表示装置300を説明するにあたり、第1の実施形態と同一または同等の構成に対しては同符号を付し、重複する説明は省略する。

[0046]

図6は、本発明の第3の実施形態に係るEL表示装置300の画素部分を示す部分断面図である。本実施形態に係るEL表示装置300では、オーバーコート層12の厚さの異なる部分として、オーバーコート層12の後面にアレイ基板1の前面の凹凸構造と相補的形状となる凹凸形状が設けられている。すなわち、画素分離膜5の直上などアレイ基板1の前面が凸となる部分ではオーバーコート層12の後面に凹部が、それ以外の平坦で凹となる部分ではオーバーコート層12の後面に凸部が形成される。これにより、アレイ基板1の前面が凸となる部分におけるアレイ基板1の前面が凹となる部分におけるアレイ基板1の前面が凹となる部分におけるアレイ基板1の前面と封止基板9の後面間の距離d2との差が小さくなるか、又は等しくなる。このことは、封止層8の面内の厚さの変化が小さくなるということでもある。

[0047]

このような構造によれば、封止層 8 を形成するべく、アレイ基板 1 と封止基板 9 間に封止樹脂を充填する際に、アレイ基板 1 の前面と封止基板 9 の後面間の距離が不均等であることに起因して、封止樹脂が充填されない領域が発生することが防止される。

[0048]

なお、本実施形態におけるオーバーコート層12における凹凸形状もまた、オーバーコート層12を形成する際に、フォトリソグラフィの手法を用い、エッチングを行ったり、いわゆるハーフ露光を行ったりすることにより形成することができる。

[0049]

なお、以上説明した実施形態において示した各部材の具体的な形状や配置、数等は一例であり、本発明をこれらに限定するものではない。当業者は本発明を実施するにあたり、その実施の態様に応じてこれら各部材の形状等を任意に設計及び変更してよい。

【符号の説明】

[0050]

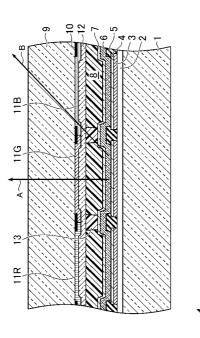
1 アレイ基板、2 回路層、3 反射層、4 下部電極、5 画素分離膜、6 EL層、7 上部電極、8 封止層、9 封止基板、10 ブラックマトリクス、11R,11G,11B カラーフィルタ、12 オーバーコート層、13 柱状スペーサ、14 開口部分、15 突起部分、20 画素、21 表示領域、22 走査回路、23 走査信号線、24 駆動回路、25 映像信号線、26 FPC、100,200,300,400 EL表示装置。

10

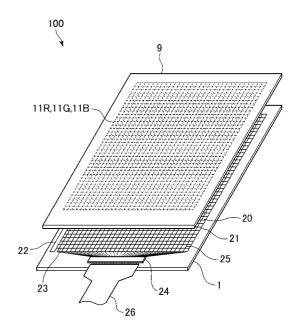
20

30

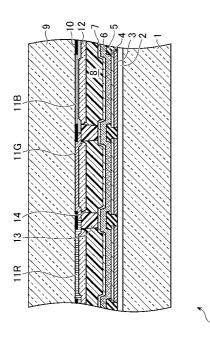
【図1】



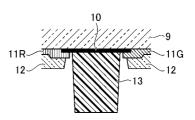
【図2】



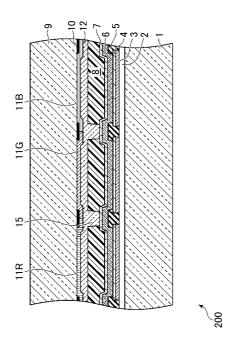
【図3】

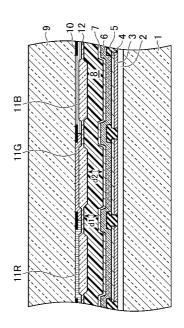


【図4】



【図5】





્રેક



专利名称(译)	EL表示装置				
公开(公告)号	<u>JP2014127353A</u>	公开(公告)日	2014-07-07		
申请号	JP2012283408	申请日	2012-12-26		
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日本显示器				
申请(专利权)人(译)	有限公司日本显示器				
[标]发明人	徳田尚紀 豊田裕訓				
发明人	徳田 尚紀 豊田 裕訓				
IPC分类号	H05B33/12 H01L51/50 H05B33/14 H05B33/04				
FI分类号	H05B33/12.E H05B33/14.A H05B33/14.Z H05B33/04				
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/AA05 3K107/BB01 3K107/CC33 3K107/CC35 3K107/EE22 3K107/EE27 3K107 /EE42 3K107/EE49				
外部链接	Espacenet				

摘要(译)

解决的问题:在彩色滤光片型EL显示装置中,即使在高精细或紧凑的显示装置中,也可以减少由于色彩混合而导致的图像质量下降。基板1包括:每个像素在正面上形成的下部电极4;将下部电极4隔开的像素分离膜5;以及在下部电极4的上层和像素分离膜5上形成的白色发光EL层6;密封基板9,其背面具有黑底10,彩色滤光片11R,11G,11B和保护层 22. 密封层8和填充在阵列基板1与密封基板9之间的密封层8形成在保护层12上,其厚度与其他部分不同。

